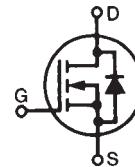


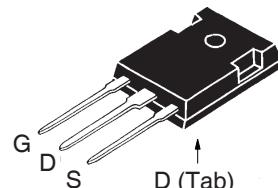
**X2-Class  
Power MOSFET**
**IXTH48N65X2**

**V<sub>DSS</sub>** = 650V  
**I<sub>D25</sub>** = 48A  
**R<sub>DS(on)</sub>** ≤ 65mΩ

N-Channel Enhancement Mode  
Avalanche Rated



TO-247



G = Gate      D = Drain  
 S = Source      Tab = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V <sub>DSS</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C	650		V
V <sub>DGR</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C, R <sub>GS</sub> = 1MΩ	650		V
V <sub>GSS</sub>	Continuous	±30		V
V <sub>GSM</sub>	Transient	±40		V
I <sub>D25</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	48		A
I <sub>DM</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C, Pulse Width Limited by T <sub>JM</sub>	96		A
I <sub>A</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	20		A
E <sub>AS</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	1.5		J
dv/dt	I <sub>S</sub> ≤ I <sub>DM</sub> , V <sub>DD</sub> ≤ V <sub>DSS</sub> , T <sub>J</sub> ≤ 150°C	50		V/ns
P <sub>D</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	660		W
T <sub>J</sub>		-55 ... +150		°C
T <sub>JM</sub>		150		°C
T <sub>stg</sub>		-55 ... +150		°C
T <sub>L</sub>	Maximum Lead Temperature for Soldering	300		°C
T <sub>SOLD</sub>	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260		°C
M <sub>d</sub>	Mounting Torque	1.13 / 10		Nm/lb.in
Weight		6		g

Symbol	Test Conditions (T <sub>J</sub> = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> = 0V, I <sub>D</sub> = 1mA	650		V
V <sub>GS(th)</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250µA	3.0		5.0 V
I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> = ±30V, V <sub>DS</sub> = 0V			±100 nA
I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>DSS</sub> , V <sub>GS</sub> = 0V T <sub>J</sub> = 125°C			10 µA 200 µA
R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> = 10V, I <sub>D</sub> = 0.5 • I <sub>D25</sub> , Note 1			65 mΩ

**Features**

- International Standard Package
- Low R<sub>DS(on)</sub> and Q<sub>G</sub>
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

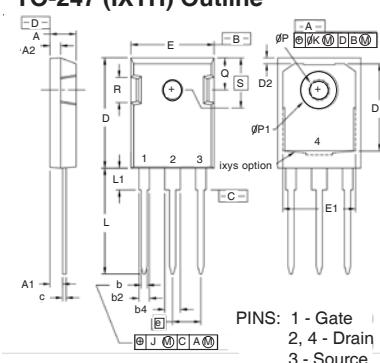
**Advantages**

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

**Applications**

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10\text{V}$ , $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ , Note 1	24	40	S
$R_{Gi}$	Gate Input Resistance		1.2	$\Omega$
$C_{iss}$	$V_{GS} = 0\text{V}$ , $V_{DS} = 25\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$	4300		pF
$C_{oss}$		3280		pF
$C_{rss}$		6.4		pF
<b>Effective Output Capacitance</b>				
$C_{o(er)}$	Energy related } $V_{GS} = 0\text{V}$	150		pF
$C_{o(tr)}$	Time related } $V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$	665		pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$ , $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$ , $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 3\Omega$ (External)	19		ns
$t_r$		26		ns
$t_{d(off)}$		50		ns
$t_f$		15		ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$ , $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$ , $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	76		nC
$Q_{gs}$		22		nC
$Q_{gd}$		28		nC
$R_{thJC}$			0.19	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{thCS}$		0.21		$^\circ\text{C}/\text{W}$

**TO-247 (IXTH) Outline**


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b2	.075	.087	1.91	2.20
b4	.115	.126	2.92	3.20
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
D1	.650	.690	16.51	17.53
D2	.035	.050	0.89	1.27
E	.620	.635	15.75	16.13
E1	.545	.565	13.84	14.35
e	.215 BSC		5.45 BSC	
J	--	.010	--	.025
K	--	.025	--	.064
L	.780	.810	19.81	20.57
L1	.150	.170	3.81	4.32
ØP	.140	.144	3.55	3.65
ØP1	.275	.290	6.99	7.37
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.242 BSC		6.15 BSC	

**Source-Drain Diode**

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
	( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Min.	Typ.	Max
$I_s$	$V_{GS} = 0\text{V}$		48	A
$I_{SM}$	Repetitive, pulse Width Limited by $T_{JM}$		192	A
$V_{SD}$	$I_F = I_S$ , $V_{GS} = 0\text{V}$ , Note 1		1.4	V
$t_{rr}$	$I_F = 24\text{A}$ , $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$	400		ns
$Q_{RM}$		6		$\mu\text{C}$
$I_{RM}$		30		A

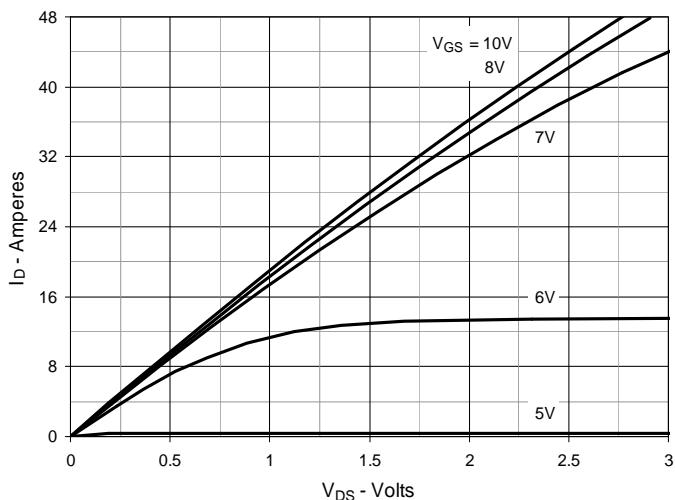
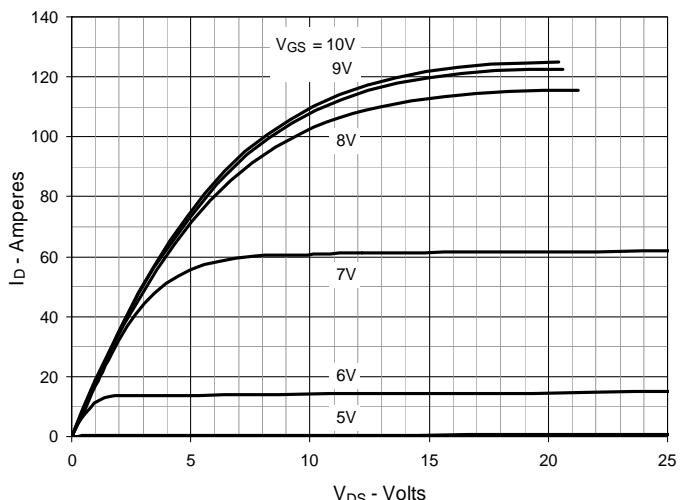
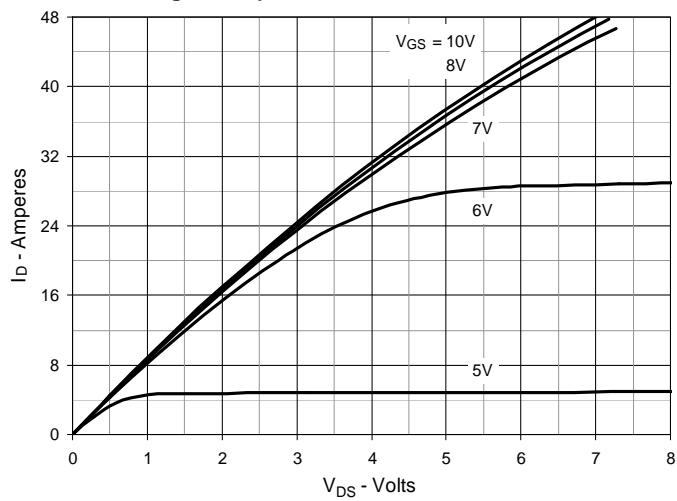
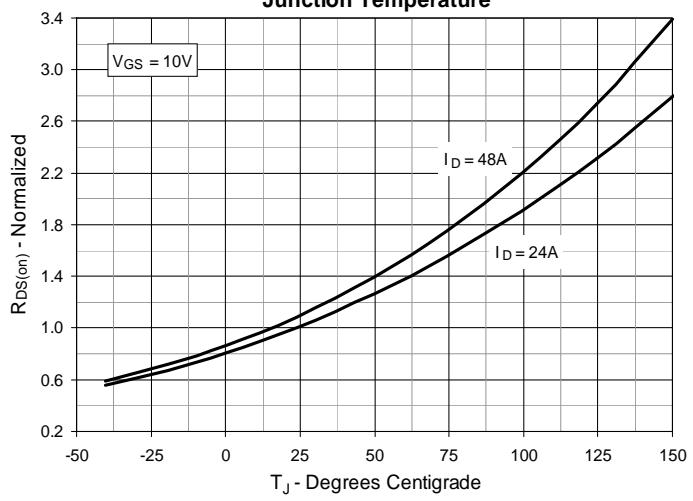
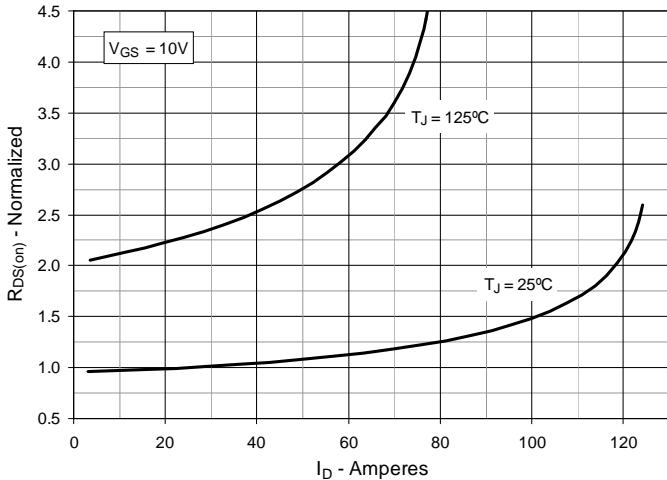
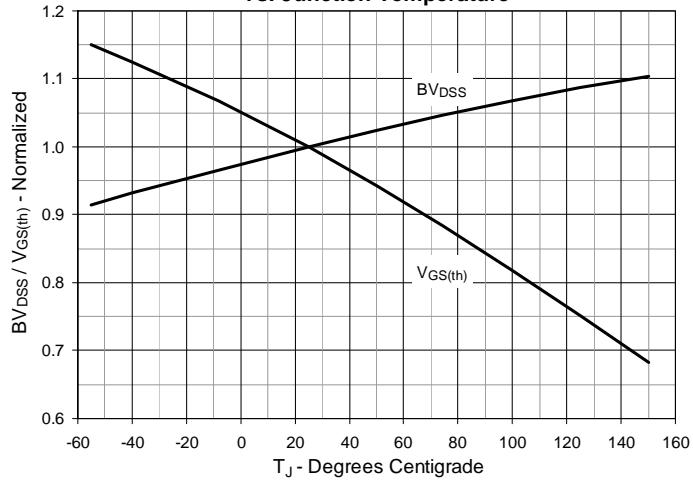
Note 1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION**

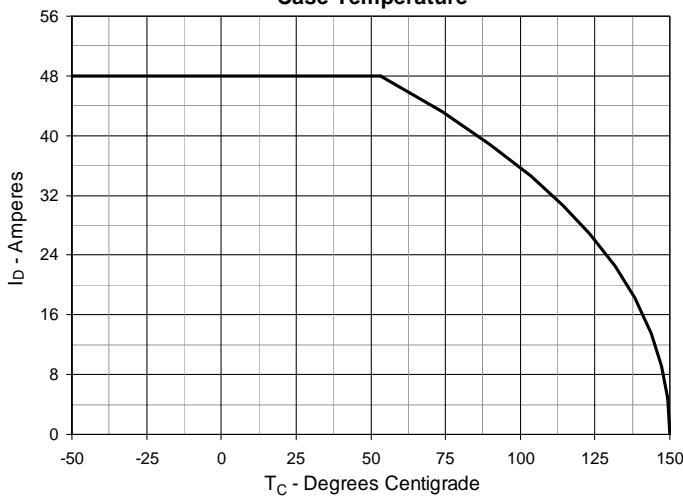
The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experience, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

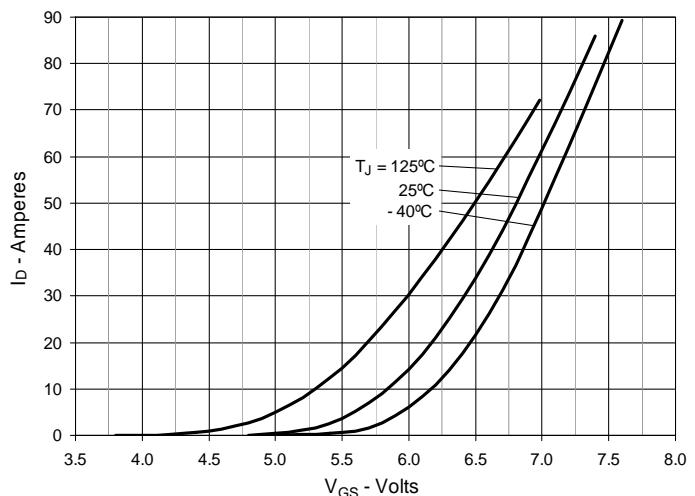
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592, 4,931,844, 5,049,961, 5,237,481, 6,162,665, 6,404,065B1, 6,683,344, 6,727,585, 7,005,734B2, 7,157,338B2, 4,860,072, 5,017,508, 5,063,307, 5,381,025, 6,259,123B1, 6,534,343, 6,710,405B2, 6,759,692, 7,063,975B2, 4,881,106, 5,034,796, 5,187,117, 5,486,715, 6,306,728B1, 6,583,505, 6,710,463, 6,771,478B2, 7,071,537

**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** **Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** **Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$** **Fig. 4.  $R_{DS(on)}$  Normalized to  $I_D = 24\text{A}$  Value vs. Junction Temperature****Fig. 5.  $R_{DS(on)}$  Normalized to  $I_D = 24\text{A}$  Value vs. Drain Current****Fig. 6. Normalized Breakdown & Threshold Voltages vs. Junction Temperature**

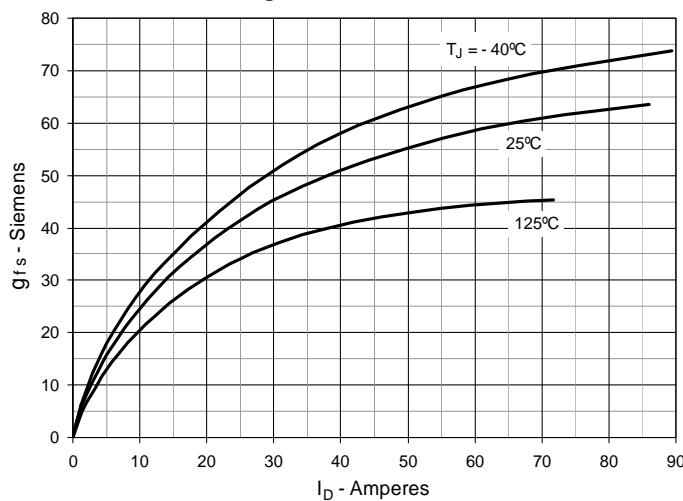
**Fig. 7. Maximum Drain Current vs.  
Case Temperature**



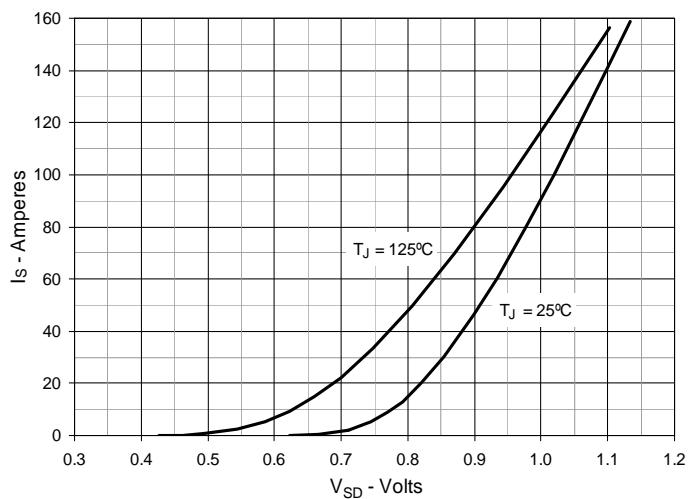
**Fig. 8. Input Admittance**



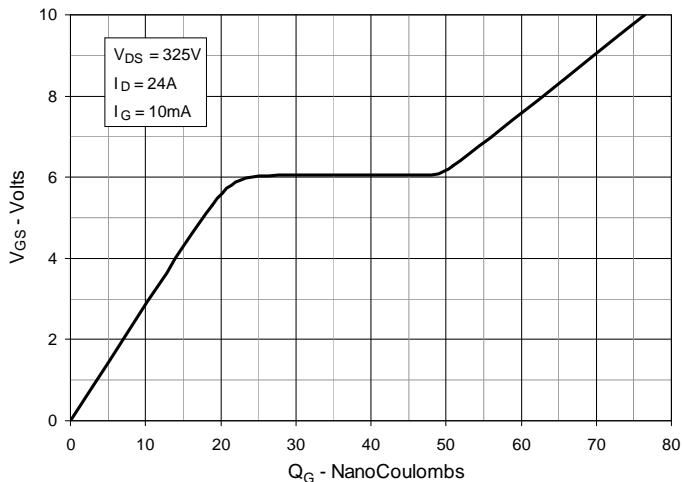
**Fig. 9. Transconductance**



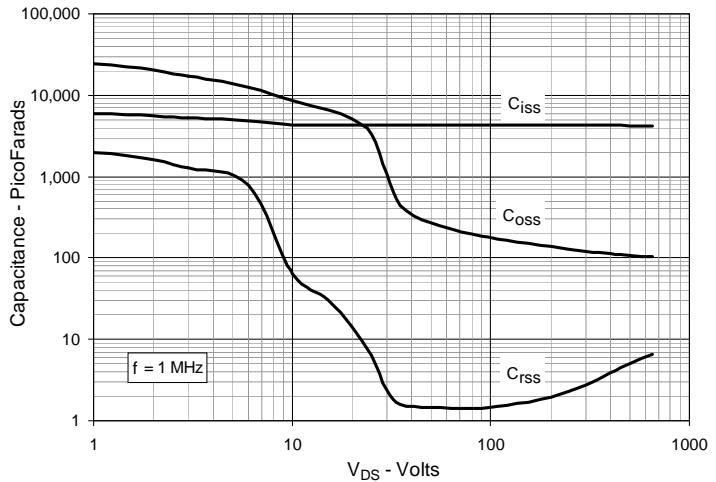
**Fig. 10. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode**

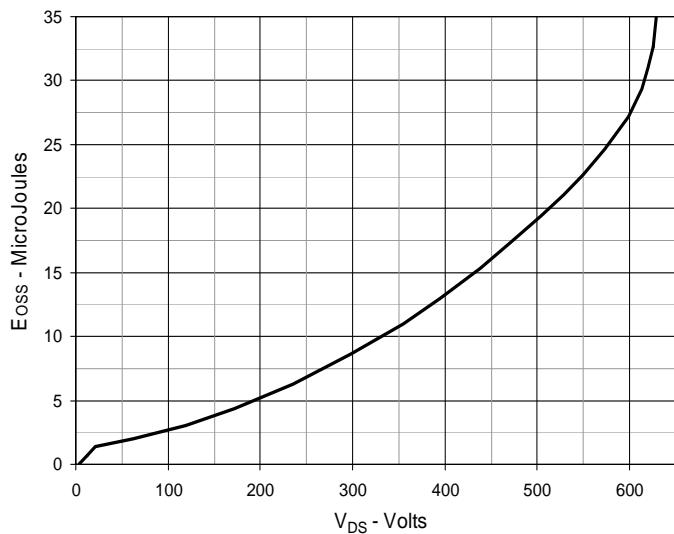
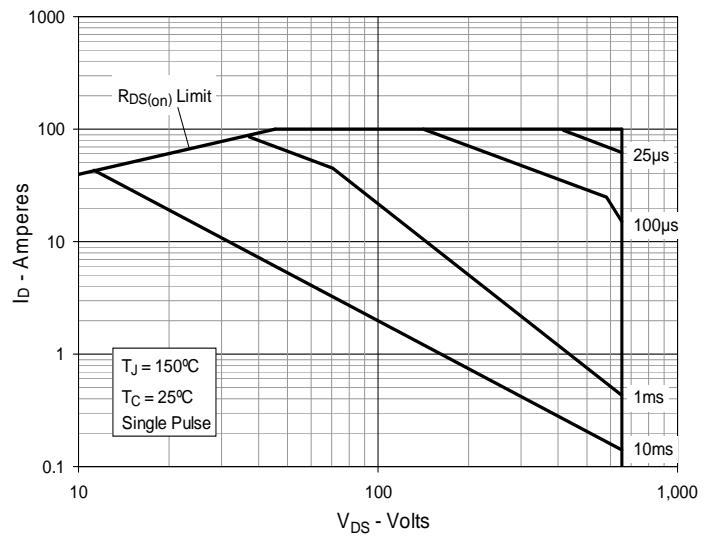
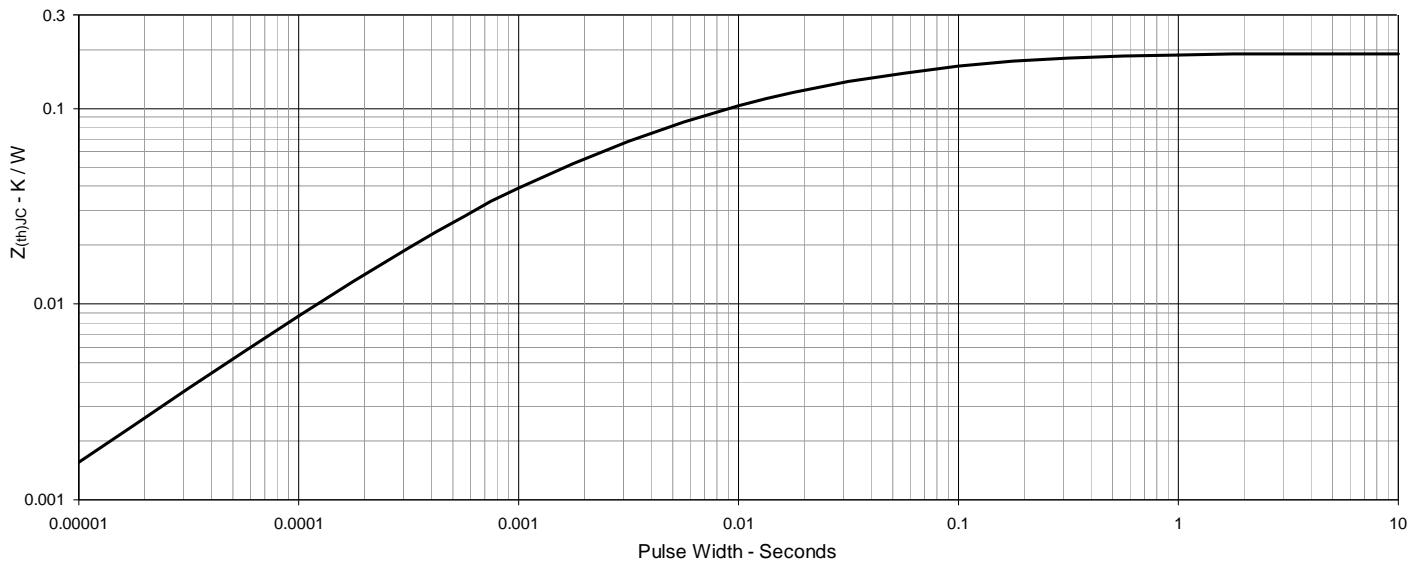


**Fig. 11. Gate Charge**



**Fig. 12. Capacitance**



**Fig. 13. Output Capacitance Stored Energy****Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area****Fig. 15. Maximum Transient Thermal Impedance**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.